

HEAT SINK COMPOUND

Für thermische Kopplung und Wärmeableitung

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Paste zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit und für die effiziente Wärmeableitung bei elektronischen Bauteilen

2. EIGENSCHAFTEN

- Hohe Wärmeleitfähigkeit
- Ausgezeichneter Feuchtigkeitspuffer
- Geringer Gehalt an metallischen Verunreinigungen

3. ANWENDUNGSBEREICHE

- Leiterplatten
- Elektronische Bauteile
- Steuergeräte

4. GEBRAUCHSANWEISUNG

- Auf einer sauberen, trockenen Oberfläche anwenden.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nicht auf stromführenden Geräten anwenden.

Für alle Produkte steht ein Sicherheitsdatenblatt (SDS) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Art. 31 und Änderungen zur Verfügung.

5. TYPISCHE PRODUKTDATEN

Aussehen:	Paste
Farbe:	weiß
Geruch:	charakteristisch
Dichte	bei 20 °C: 2,3 g/cm ³
Einsatztemperatur:	-50 °C bis 300 °C

TECHNISCHES DATENBLATT 2/2

HEAT SINK COMPOUND

6. GEBINDE

Tube: 20 g
 100 g

Alle Angaben in diesem Datenblatt basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Laboruntersuchungen. In Anbetracht der großen Vielfalt an Geräten und Bedingungen und der unvorhersehbaren menschlichen Faktoren empfehlen wir, unsere Produkte vor dem Gebrauch in der vorgesehenen Anwendung unter realen Bedingungen selbst zu testen. Alle Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne ausdrückliche oder implizite Garantie, bereitgestellt.

Es ist möglich, dass dieses Technische Datenblatt aus bestimmten Gründen, etwa im Zusammenhang mit Änderungen in der Gesetzgebung oder bei der Verfügbarkeit von Komponenten oder aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse, bereits aktualisiert worden ist. Die neueste und einzig gültige Version dieses Technischen Datenblatts wird Ihnen auf Anfrage zugesandt und ist auf unserer Website zu finden: www.crcind.com.

Wir empfehlen Ihnen, sich auf unserer Website für dieses Produkt registrieren zu lassen, um zukünftige aktualisierte Versionen automatisch zu erhalten.

Version: 4.2

Datum: 06.11.2021

